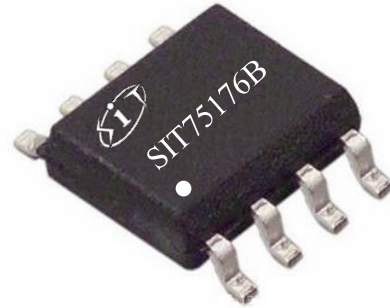


**特点:**

- 3.0~5.5V 电源范围, 半双工;
- 总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15KV 以上;
- 总线容错耐压达到  $\pm 15V$ ;
- 驱动器短路输出保护;
- 低功耗关断功能;
- 接收器开路失效保护;
- 具有较强的抗噪能力;
- 集成的瞬变电压抵制功能;
- 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 10Mbps;

**产品外形:**


提供绿色环保无铅封装

**描述**

SIT75176B 是一款 3.0V~5.5V 电源供电、总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15KV 以上、总线耐压范围达到  $\pm 15V$ 、半双工、低功耗, 功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器, 最多允许 32 个节点同时连接到总线。

SIT75176B 包括一个驱动器和一个接收器, 两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时, 驱动器与接收器均输出高阻态。可实现高达 10Mbps 的无差错数据传输。

SIT75176B 工作电压范围为 3.0~5.5 V, 具备失效安全 (fail-safe)、限流保护、过压保护等功能。

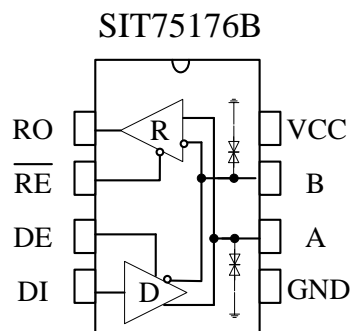
**引脚分布图**


图 1 SIT75176B 引脚分布图

**极限参数**

参数	符号	大小	单位
电源电压	VCC	+7	V
控制端口电压	/RE, DE, DI	-0.3~VCC+0.5	V
总线侧输入电压	A、B	-15~+15	V
接收器输出电压	RO	-0.3~VCC+0.5	V
工作温度范围		-40~125	°C
存储工作温度范围		-60~150	°C
焊接温度范围		300	°C

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

**引脚定义**

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	RO	接收器输出端。 当/RE 为低电平时，若 $A-B \geq 200\text{mV}$ ，RO 输出为高电平； 若 $A-B \leq -200\text{mV}$ ，RO 输出为低电平。
2	/RE	接收器输出使能控制。 当/RE 接低电平时，接收器输出使能，RO 输出有效；当/RE 接高电平时，接收器输出禁能，RO 为高阻态； /RE 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
3	DE	驱动器输出使能控制。 DE 接高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态； /RE 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
4	DI	DI 驱动器输入。DE 为高电平时，DI 上的低电平使驱动器同相端 A 输出为低电平，驱动器反相端 B 输出为高电平；DI 上的高电平将使同相端输出为高电平，反相端输出为低。
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出端
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出端
8	VCC	接电源

**驱动器直流电学特性**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出 (无负载)	$V_{OD1}$		2.5		5.5	V
驱动差分输出	$V_{OD2}$	图 2, $R_L = 54 \Omega$ , $V_{CC} = 3.3V$	1.5	1.8	VCC	V
		图 2, $R_L = 54 \Omega$ , $V_{CC} = 5V$	1.5	3	VCC	
输出电压幅值的变化 (NOTE1)	$\Delta V_{OD}$	图 2, $R_L = 54 \Omega$			0.2	V
输出共模电压	$V_{OC}$	图 2, $R_L = 54 \Omega$			3	V
共模输出电压幅值 的变化 (NOTE1)	$\Delta V_{OC}$	图 2, $R_L = 54 \Omega$			0.2	V
高电平输入	$V_{IH}$	DE, DI, /RE	2.0			V
低电平输入	$V_{IL}$	DE, DI, /RE			0.8	V
逻辑输入电流	$I_{IN1}$	DE, DI, /RE	-2		2	$\mu A$
输出短路时的电流, 短路到高	$I_{OSD1}$	短路到 0V~12V			250	mA
输出短路时的电流, 短路到低	$I_{OSD2}$	短路到 -7V~0V	-250			mA

(如无另外说明,  $Temp = T_{MIN} \sim T_{MAX}$ ,  $Temp = 25^\circ C$ ,  $V_{CC} = 5V$ )

NOTE1:  $\Delta V_{OD}$  和  $\Delta V_{OC}$  分别是输入信号 DI 状态变化时引起的  $V_{OD}$  与  $V_{OC}$  幅值的变化。

**接收器直流电学特性**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电流 (A, B)	$I_{IN2}$	DE = 0 V, VCC=0 或 5V $V_{IN} = 12 V$		500	1000	$\mu A$
		DE = 0 V, VCC=0 或 5V $V_{IN} = -7 V$	-800	-300		$\mu A$

正向输入阈值电压	$V_{IT+}$	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$			200	mV
反向输入阈值电压	$V_{IT-}$	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	-200			mV
输入迟滞电压	$V_{hys}$	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	10	30		mV
高电平输出电压	$V_{OH}$	$I_{OUT} = -2.5mA,$ $V_{ID} = +200 mV$	$V_{CC}-1.5$			V
低电平输出电压	$V_{OL}$	$I_{OUT} = +2.5mA,$ $V_{ID} = -200 mV$			0.4	V
三态输入漏电流	$I_{OZR}$	$0.4 V < V_O < 2.4 V$			$\pm 1$	$\mu A$
接收端输入电阻	$R_{IN}$	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	12			k $\Omega$
接收器短路电流	$I_{OSR}$	$0 V \leq V_O \leq V_{CC}$	$\pm 8$		$\pm 90$	mA

 (如无另外说明,  $Temp = T_{MIN} \sim T_{MAX}$ ,  $Temp = 25^{\circ}C$ )

### 供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电电流	$I_{CC1}$	/RE=0V, DE = 0 V, VCC=3.3V		240	650	$\mu A$
		/RE=0V, DE = 0 V VCC=5V		270	750	$\mu A$
	$I_{CC2}$	/RE=VCC, DE=VCC, VCC=3.3V		360	650	$\mu A$
		/RE=0V, DE = 0 V, VCC=5V		400	750	$\mu A$
关断电流	$I_{SHDN}$	/RE=VCC, DE=0V, VCC=3.3V		0.2	10	$\mu A$
		/RE=VCC, DE=0V, VCC=5V		0.2	10	$\mu A$

**驱动器开关特性**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出延迟	$t_{DD}$	$R_{DIFF} = 60 \Omega$ , $C_{L1} = C_{L2} = 100pF$ (见图 3 与图 4)		15	22	ns
驱动器差分输出过渡时间	$t_{TD}$			20	30	ns
使能到输出高	$t_{PZH}$	$R_L = 110 \Omega$ , (见图 5、6)		25	120	ns
使能到输出低	$t_{PZL}$			25	60	ns
输入低到禁能	$t_{PLZ}$	$R_L = 110 \Omega$ , (见图 5、6)		20	30	ns
输入高到禁能	$t_{PHZ}$			25	250	ns

**接收器开关特性**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器输入到输出传播延迟从低到高	$t_{RPLH}$	$C_L = 15pF$ 见图 7 与图 8		25	35	ns
接收器输入到输出传播延迟从高到低	$t_{RPHL}$			25	35	ns
使能到输出低时间	$t_{RPZL}$	$C_L = 15pF$ 见图 7 与图 8		15	20	ns
使能到输出高时间	$t_{RPZH}$	$C_L = 15pF$ 见图 7 与图 8		15	20	ns
从输出低到禁能时间	$t_{PRLZ}$	$C_L = 15pF$ 见图 7 与图 8		15	25	ns
从输出高到禁能时间	$t_{PRHZ}$	$C_L = 15pF$ 见图 7 与图 8		20	35	ns

**功能表**
**发送功能表**

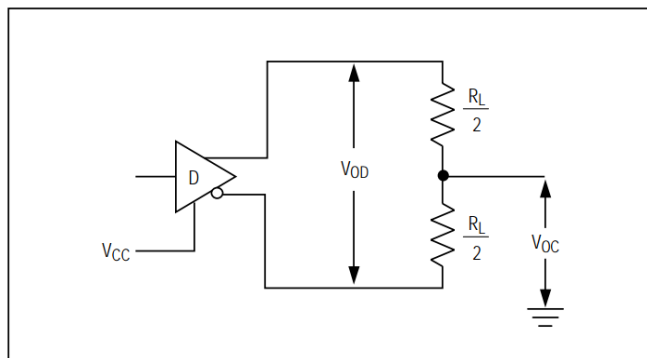
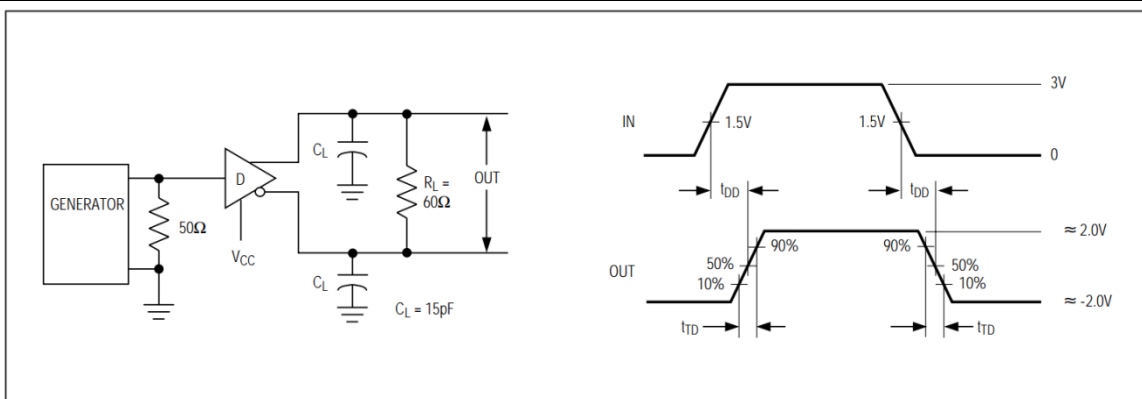
控制		输入	输出	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	1	H	L
X	1	0	L	H
0	0	X	Z	Z
1	0	X	Z(shutdown)	

X: 任意电平; Z: 高阻。

**接收功能表**

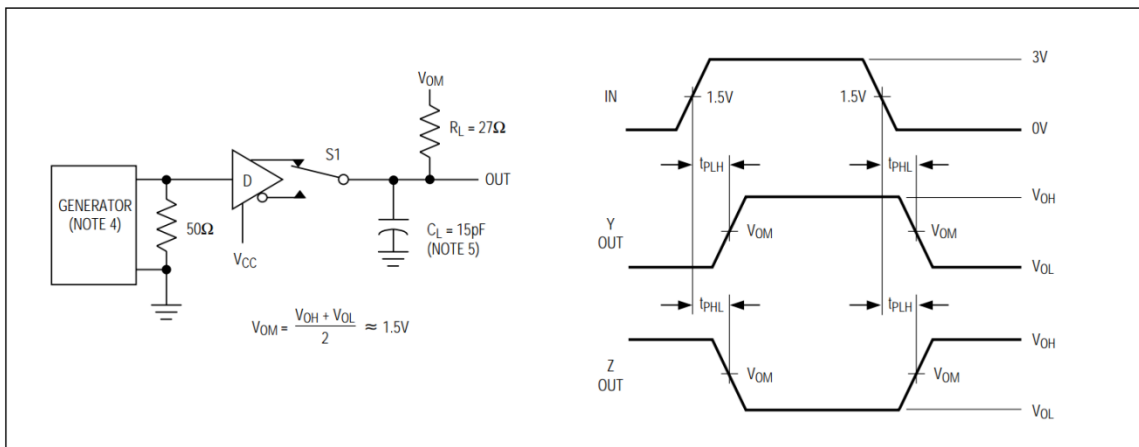
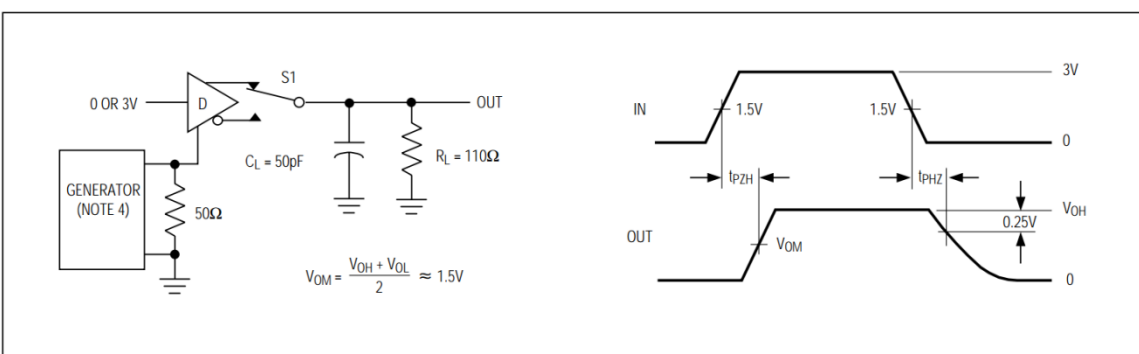
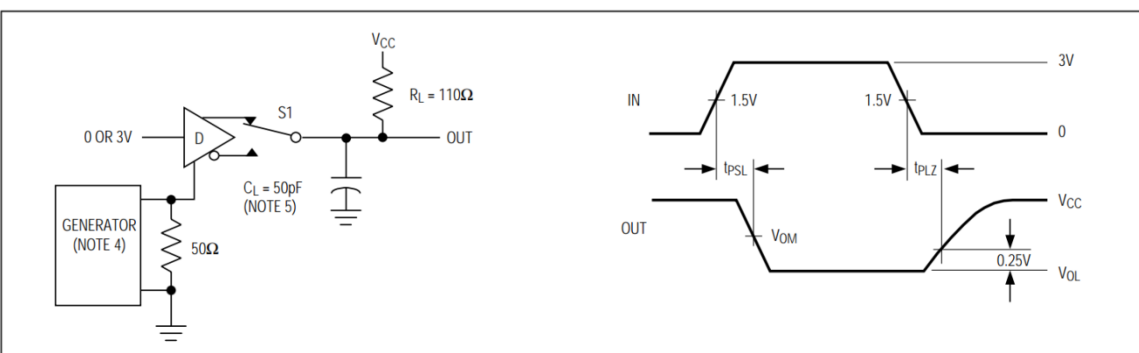
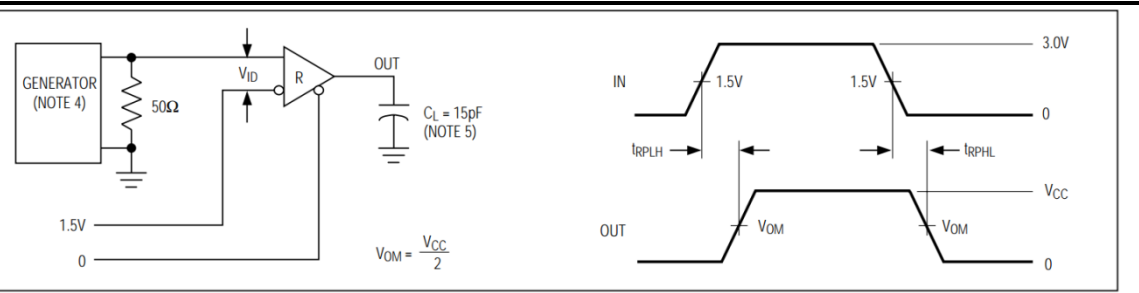
控制		输入	输出
/RE	DE	A-B	RO
0	X	$\geq 200\text{mV}$	H
0	X	$\leq -200\text{mV}$	L
0	X	开/短路	H
1	X	X	Z

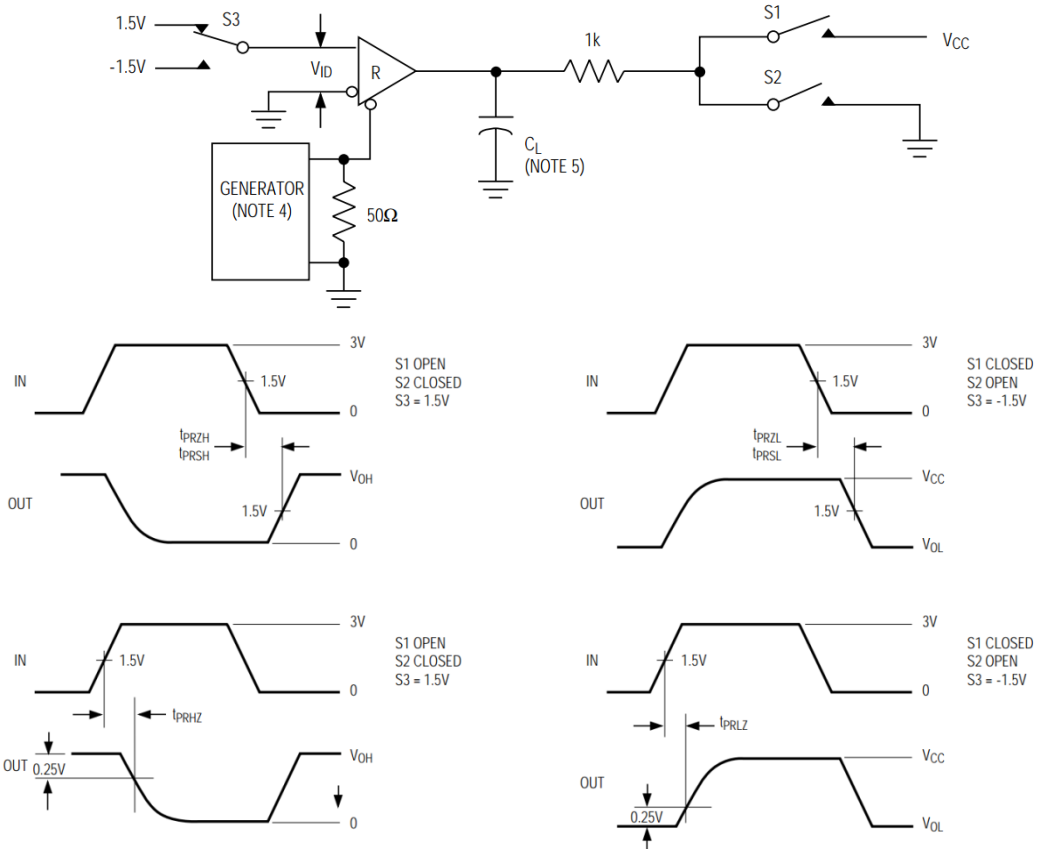
X: 任意电平; Z: 高阻。

**测试电路**

**图 2 驱动器直流测试负载**


CL 包含探针以及杂散电容（下同）

**图 3 驱动器差分延迟与渡越时间**


**图 4 驱动器传播延迟**

**图 5 驱动器使能与禁能时间**

**图 6 驱动器使能与禁能时间**


**图 7 接收器传播延时测试电路**

**图 8 接收器使能与禁能时间**



**说明**
**1 简述**

SIT75176B 是一款 3.0V~5.5V 电源供电、总线端口接触放电能力达到 15kV 以上、总线直流耐压达到 ±15V 以上、用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器，包含一个驱动器和接收器。具有失效安全，过压保护、过流保护功能。SIT75176B 实现高达 10Mbps 的无差错数据传输，最多允许 32 个节点同时连接到总线。

**2 驱动器输出保护**

通过过流、过压保护机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高，在整个共模电压范围（参考典型工作特性）内提供快速短路保护。

**3 典型应用**

**3.1 总线式组网：**SIT75176B RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 9 显示了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器，为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

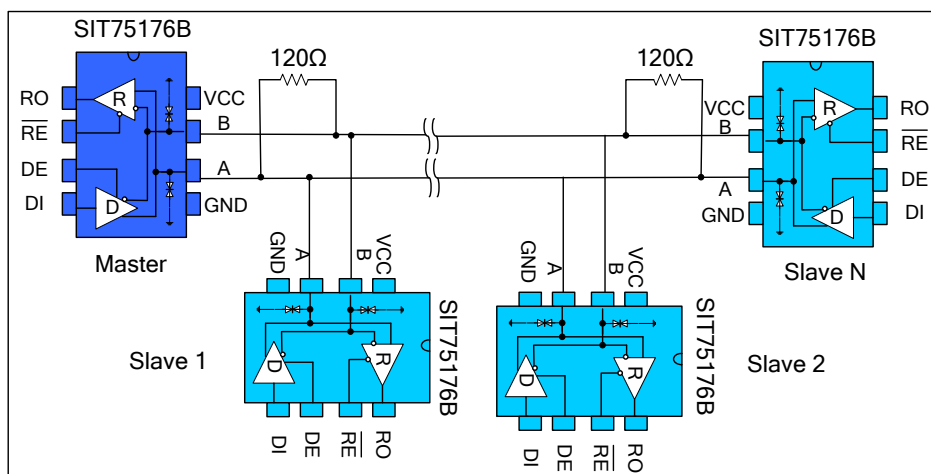


图 9 总线式 RS485 半双工通讯网络

**3.2 手拉手式组网：**又称菊花链拓扑结构，是 RS485 总线布线的标准及规范，是 TIA 等组织推荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式，如图 10 所示，不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式，具有信号反射小，通讯成功率高等优点。

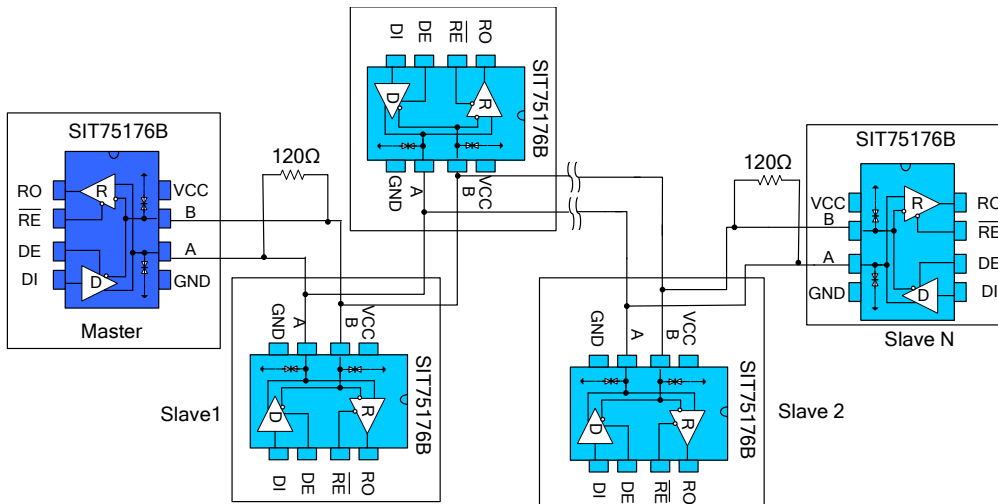


图 10 手拉手式 RS485 半双工通讯网络

**3.3 总线端口防护:** 在恶劣的环境下, RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额外的防护, 甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案, 以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 11 为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地, AB 端口之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案; 第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻, AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案; 第三种为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地, AB 之间接 TVS, A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。

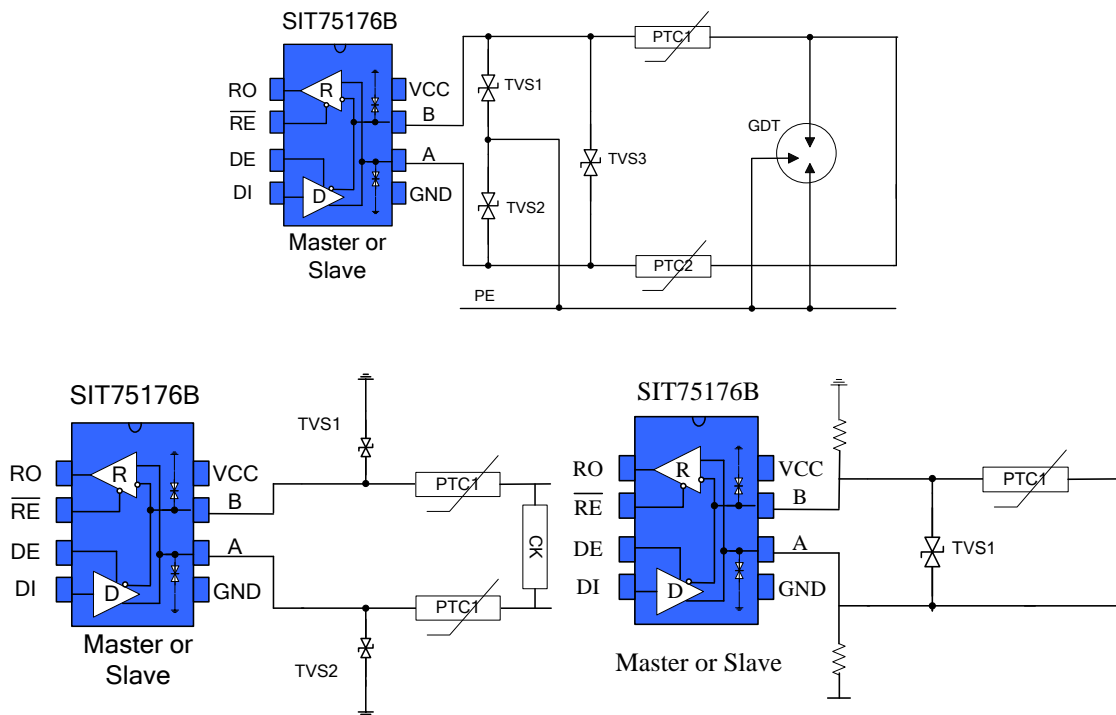
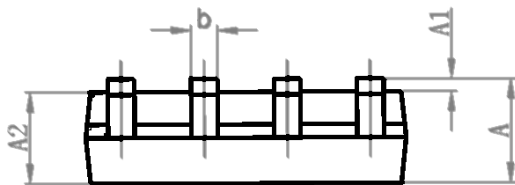
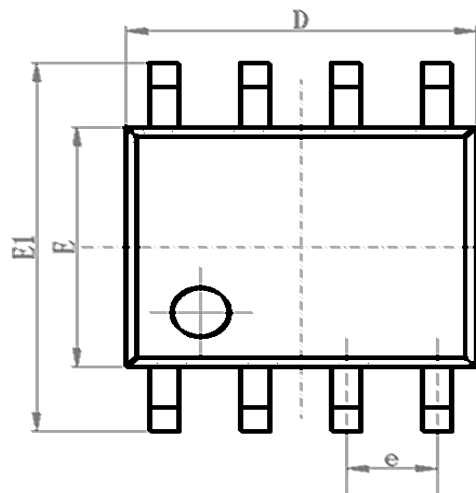


图 11 端口防护方案

**SOP8 外形尺寸**

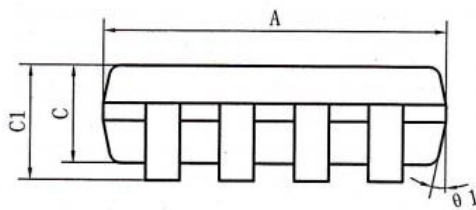
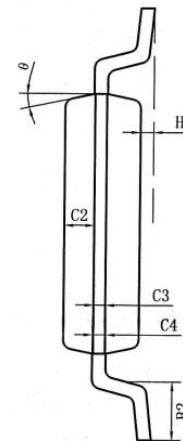
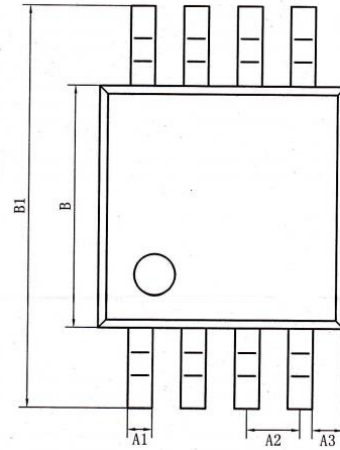
封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	1.50	1.60	1.70
A1	0.1	0.15	0.2
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.355	0.400	0.455
D	4.800	4.900	5.00
E	3.780	3.880	3.980
E1	5.800	6.000	6.200
e		1.270BSC	
L	0.40	0.60	0.80
c	0.153	0.203	0.253
$\theta$	$-2^{\circ}$	$-4^{\circ}$	$-6^{\circ}$



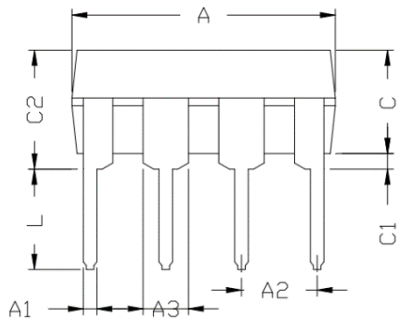
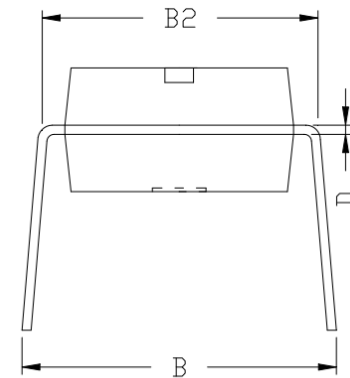
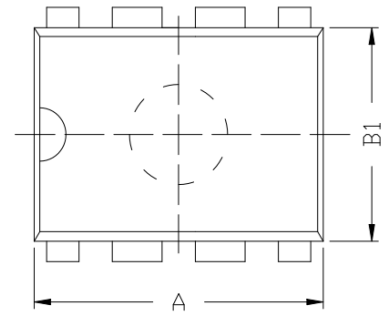
**MSOP8 /8μMAX / VSSOP8 外形尺寸**
**封装尺寸**

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	2.90	3.0	3.10
A1	0.28		0.35
A2	0.65TYP		
A3	0.375TYP		
B	2.90	3.0	3.10
B1	4.70		5.10
B2	0.45		0.75
C	0.75		0.95
C1			1.10
C2	0.328 TYP		
C3	0.152		
C4	0.15		0.23
H	0.00		0.09
$\theta$	12 °TYP		



**DIP8 外形尺寸**
**封装尺寸**

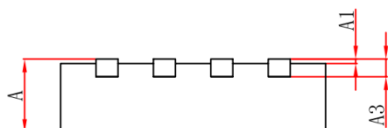
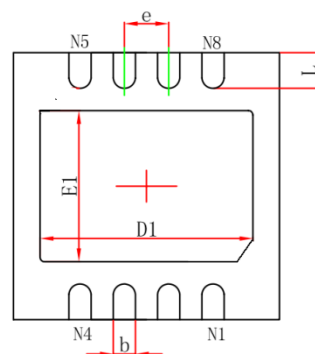
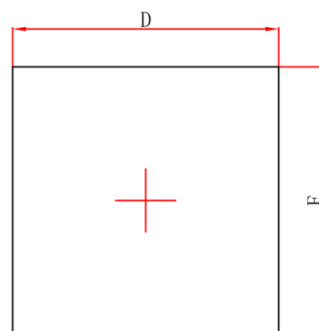
符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	9.00	9.20	9.40
A1	0.33	0.45	0.51
A2	2.54TYP		
A3	1.525TYP		
B	8.40	8.70	9.10
B1	6.20	6.40	6.60
B2	7.32	7.62	7.92
C	3.20	3.40	3.60
C1	0.50	0.60	0.80
C2	3.71	4.00	4.31
D	0.20	0.28	0.36
L	3.00	3.30	3.60



**HVSON8 / DFN3\*3-8 外形**

封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	0.700		0.900
A1	0.000	0.02	0.050
A3	0.203 REF		
D	2.900	3.000	3.100
E	2.900	3.000	3.100
D1	2.200	2.3	2.400
E1	1.400	1.5	1.600
b	0.2	0.25	0.33
e	0.650 TYP		
L	0.250		0.575


**订购信息**

订购代码	温度	封装
SIT75176BDR	-40°C~125°C	SOP8
SIT75176BDGK	-40°C~125°C	MSOP8/VSSOP8/8μMAX
SIT75176BP	-40°C~125°C	DIP8
SIT75176BTK	-40°C~125°C	HVSON8 / DFN3*3-8, 小外形, 无引脚

编带式包装为 2500 颗/盘, HVSON8 / DFN3\*3-8, 小外形, 无引脚封装为 5000 颗/盘。